

# X7058

上下面の100 %  
3DのX線検査

両面実装型組立品における面  
セパレーションの自動化

プリント回路基板の寸法:  
max. 558 mm x 508 mm

FastFlowハンドリングによる  
超高速スループットおよび複数  
チャンバー通過方式

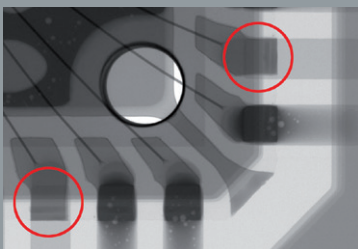
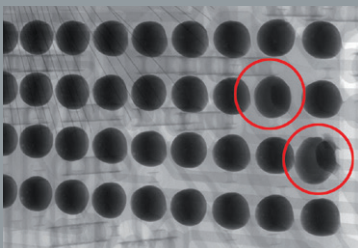
vVisionにより直感的操作や  
簡単な検査プログラム作成



## 全面3DのX線検査 – 自動、インライン、超高速

Viscomは新世代X線検査システムX7058を提供。全面3DのX線検査専用に開発された高速システムです。X線テクノロジーの中核をなすのが、閉鎖型高性能マイクロフォーカスX線管です。専用に開発した全面3Dセンサーが最適なコントラストと卓越した画質を実現します。このシステムでは上下面の自動セパレーションが可能です。これによって、複雑な重なり部分のセパレーションが可能だけでなく、典型的なSMT欠陥全てを確実に検出できます。

Viscom FastFlowハンドリングにより、X7058は超高速です。更に、複数のチャンバーを通過する独特のハンドリングコンセプトにより、最高度のスループットを達成します。少品種大量生産要求に最適です。vVisionオペレーションソフトは、直感的ハンドリングや簡単なプログラム作成を保証します。X7058は、実証済みのViscom-AOIシステムと同一のユーザーインターフェースを提供します。このため、トレーサビリティが簡単に実現します。インテリジェントなViscom TrueYieldアプリケーションにより、ラインのネットワーク化や、閉ループ等の欠陥検出が達成されます。更に、統合的検証やQuality Uplink、統計的プロセスコントロールを加わると万全です。



# 3D-AXI

## X7058

検査コンセプト AXI

### X線技術

X線管	密閉型X線管
高電圧	10~130 kV
X線管電流	50~390 $\mu$ A
センサー	ラインスキャンカメラ
解像度	8~25 $\mu$ m
Z軸の調節	モーターによる管のz位置決め
X線キャビネット	RöV (X線規定) による完全防護機器の要求に対応して設計 放射能漏れ率 < 1 $\mu$ Sv/h

### ソフトウェア

ユーザーインターフェース	Viscom vVision
検証ステーション	Viscom vVerify
SPC	Viscom SPC (統計的プロセス・コントロール)、 オープンインターフェース(オプション)
リモートメンテナンス	Viscom SRC (オプション)
オフラインプログラミング	Viscom PST34 (外付けプログラミングステーション)(オプション)

### 解析コンピュータ

オペレーションシステム	Windows®
プロセッサ	Intel® Core™ i7

### プリント回路基板のハンドリング

プリント回路基板の寸法	max. 558 mm x 508 mm (長さ x 幅)
搬送物高さ	870~960 mm $\pm$ 20 mm
幅の設定	自動
基板はみ出し幅	3 mm
上部通過クリアランス	15~50 mm
下部通過クリアランス	60 mm

### その他のシステムデータ

インターフェース	SMEMA, SV70、顧客の要求に個別に対応
電源	400 V(その他の電圧値はお問合わせ次第)、3P/N/PE, 11 A
システム寸法	1992 mm x 1902 mm x 1942 mm (幅 x 高さ x 奥行き) (シグナル塔を含む)
ライン統合寸法	+25 mm
重量	2400 kg

